



Gowin DDR3 参考设计 发布说明

RN281-1.00, 2018-07-24

版权所有 © 2018 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	说明
2018/07/24	1.0	初始版本。

目录

目录	i
关于发布	1
功能和增强总述	2
平台支持	3
文档	4

关于发布

本次发布 Gowin DDR3 参考设计。

Gowin DDR3 参考设计可在高云官网下载，参考设计可用于仿真，实例化加插用户设计后的总综合，总布局布线。

功能和增强总述

IP 发布功能和增强项如下表所述：

功能	描述
前端综合工具：SynplifyPro 版本 N-2018.03G-Beta7	
支持 DDR3	数据读写等操作
后端布局布线工具：GoWinYunYuan_V1.8.1Beta	
增强项	-
器件支持	<ul style="list-style-type: none">● GW2A-18● GW2A-55● GW2AR-18

平台支持

本次发布的 IP 对应软件支持的平台有：

Windows	Windows 7 旗舰版(64-bit)
Linux	Red hat Enterprise Linux 6/7 (64-bit)

文档

本次 IP 发布文档如下表所示，PDF 文档可在官网上下载或在线查看。

文档	使用
Gowin DDR3 用户指南	Online, PDF
Gowin DDR3 参考设计发布说明	Online, PDF

